

苏州德龙激光股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：投2026-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	详见附件1《投资者关系活动参与机构名单》
时间	2026年4月28日
地点	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：赵裕兴 董事、副总经理、董事会秘书：袁凌 财务总监：李苏玉 资本市场总监：洪叶

投资者关系活动主要内容

一、 董事会秘书介绍公司2025年度暨2026年第一季度经营情况

答：公司2025年度实现营业收入7.87亿元，较上年同期增加10.10%，2025年全年实现归属于上市公司股东的净利润2584.79万元，实现扭亏为盈；2026年第一季度实现营业收入0.87亿元，较去年同期下降11.93%，第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-2553.14万元，比去年同期利润减少906.10万元。

二、 问答环节

问：您好，请问公司2026年第一季度收入、利润下降是什么原因？

答：公司一季度收入历来在全年占比较低，2025年一季度收入0.99亿元，较2024年同期下降14.26%，一季度收入仅占全年的12.59%。2026年第一季度收入下滑11.93%，亏损扩大。主要是一些目标验收工作的延期导致一季度收入同比下降。2026年一季度公司新签订单增长较快，一季度末较年初存货增加23%，合同负债增加38%，为保障交付质量，公司当期资源向订单交付环节侧重，一季度营业收入出现阶段性波动，导致本期收入下滑，亏损扩大。全年公司将做好新签订单、交付、验收的工作统筹安排。

问：从行业整体来看，公司毛利率在较高水平，但是期间费用整体占比偏高，是什么原因导致的？后续有什么措施改进？

答：公司2025年度营业毛利率40.88%，研发费用率16.33%，销售费用率13.29%，管理费用率7.89%，公司费用率确实偏高，主要与公司产品定位及其所处的发展阶段有关。公司20年深耕激光精细加工应用，公司产品主要应用于半导体、消费电子、显示和新能源这些技术更新换代较快、技术门槛较高的行业，加之公司是技术驱动型企业，一直致力于新产品、新技术、新工艺的前沿研究和开发，具有较强的技术储备；公司聚焦的超快激光等高端应用场景仍处于发展早期，下游应用布局较为零散，公司客户结构相对分散；这就需要公司相对多元地布局业务点，因此阶段性推高了整体费用率。但是公司积累了超快激光及其应用的一系列核心底层技术，积累了一批行业龙头客户，随着超快应用在高端制造业的逐步渗透、发展，公司将陆续形成有批量的大单品，同时侧重大客户的开发与维护，从而有效降低研发费用率和销售费用率。

问：请介绍一下公司针对存储芯片的业务布局及产品规划。

答：公司在半导体板块尤其是晶圆隐形切割领域已深耕十几年，积累了一系列核心技术及优质客户资源。近年来，公司积极布局高端芯片领域，存储类超薄芯片对性能、稳定性、可靠性及切割效果要求较高，公司对此推出了自主研发的硅晶圆激光隐切设备，该设备针对12英寸硅存储芯片研发，全面支持SDAG（研磨后隐切）与SDBG（研磨前隐切）工艺，特别适用于厚度35~85 μm 的超薄晶圆隐切与减薄前加工，是先进封装制程中不可或缺的关键装备。该设备已获得存储芯片头部厂商的首个国产量产订单，并在今年初获得了小批量复制订单，也进一步验证了该产品国产化进程的顺利进展。

在存储芯片业务方面，公司今年重点要保障该产品的交付，保证服务好客户的量产需求。同时今年重点推进对其他存储芯片设计厂商及代工厂的验证与推广工作。在研发方面，公司针对存储芯片隐形切割设备正在做下一代新机的研发升级，同时也在配合客户进行飞秒激光开槽等新需求的开发。

问：请介绍一下公司在玻璃基板TGV工艺的布局及进展。

答：公司在玻璃基板TGV（Through Glass Via 玻璃通孔）工艺方面已深耕多年，相关产品已进入市场多年并形成销售。同时随着下游客户应用需求的变化及对工艺要求的提升，公司持续在进行TGV技术的升级迭代。公司观察到玻璃基板在半导体、光通信等方向的应用潜力，

因此持续重视并投入相关研发。激光诱导是玻璃基板加工中的一个重要环节，但也与前后道湿法制程紧密相关，为了更好地推进TGV业务的拓展，公司已与合作方建成包含湿法清洗、激光诱导、湿法刻蚀等全工艺试验线，用于TGV技术产业化推进。

问：请问公司有哪些重点研发方向？

答：公司重点研发方向：

- 1、存储芯片隐切设备升级：飞秒开槽设备开发；
- 2、高阶 HDI 线路板激光钻孔技术；
- 3、玻璃基板 TGV 工艺；
- 4、固态电池超快应用开发：包括绝缘、切割等；
- 5、50KW 半导体激光匀光加热系统。

附件清单（如有）	《投资者关系活动参与机构名单》
日期	2026年4月28日

附件1《投资者关系活动参与机构名单》（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	中信证券股份有限公司	28	亿能股权投资基金管理（北京）有限公司
2	中信建投证券股份有限公司	29	誉辉资本管理（北京）有限责任公司
3	中信证券资产管理有限公司	30	泾溪投资管理有限公司
4	红杉资本中国基金	31	深圳猎投资本管理有限公司
5	长江证券股份有限公司	32	广东瑞天私募基金管理有限公司
6	长城证券股份有限公司	33	上海益和源资产管理有限公司
7	兴业证券股份有限公司	34	冯源投资（平潭）有限公司
8	浙商证券资产管理有限公司	35	源乘投资管理有限公司
9	国泰海通证券股份有限公司	36	深圳前海百川基金管理有限公司
10	金元证券股份有限公司	37	华夏未来文化艺术基金会
11	信达证券股份有限公司	38	信银理财有限责任公司
12	华源证券股份有限公司研究所	39	合众资产管理股份有限公司
13	申万宏源集团股份有限公司	40	宁银理财有限责任公司
14	盛松投资有限公司	41	上海彤源投资发展有限公司
15	金鹰基金管理有限公司	42	北京闻天国际投资管理有限公司
16	苏州宏道投资发展有限公司	43	金建投资发展有限公司
17	北京静衡投资管理有限公司	44	浙江象舆行投资管理有限公司
18	五聚投资管理有限公司	45	长信基金管理有限责任公司
19	广金投资有限公司	46	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
20	清淙投资管理有限公司	47	睿远基金管理有限公司
21	鑫盛寰宇投资管理有限公司	48	昊泽致远（北京）投资管理有限公司
22	红土创新基金管理有限公司	49	工银理财有限责任公司
23	中信金石投资有限公司	50	新华基金管理股份有限公司
24	浙江源弈资产管理有限公司	51	景顺长城基金管理有限公司
25	中国国际金融股份有限公司	52	上海健顺投资管理有限公司
26	国富联合（青岛）私募基金管理有限公司	53	上海方物私募基金管理有限公司
27	浙江灵睿信息科技有限公司	54	誉辉资本管理（北京）有限责任公司